

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年4月24日(2014.4.24)

【公開番号】特開2012-212712(P2012-212712A)

【公開日】平成24年11月1日(2012.11.1)

【年通号数】公開・登録公報2012-045

【出願番号】特願2011-76410(P2011-76410)

【国際特許分類】

H 01 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/60 3 2 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成26年3月10日(2014.3.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材上の一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、

前記複数のパッド部の一方の上に電気的に接続するように設けられている半導体装置と

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、

前記半導体装置の上に設けられている接合材と、

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と、接するように設けられている接続部材と、

を有し、

前記接続部材は、前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接する第1の接合部材と、

前記半導体装置の上に設けられている接合材と接する第2の接合部材と、

前記第1の接合部材と前記第2の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第1の部材と、

前記第1の部材を支持し、前記第1の接合部材と接続している第2の部材と、

前記第1の部材を支持し、前記第2の接合部材と接続している第3の部材と、

を有することを特徴とする半導体装置の実装構造。

【請求項2】

前記接続部材は、板状であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の実装構造。

。

【請求項3】

前記第3の部材の長さは、前記第1の接合部材と前記第2の接合部材の厚みの合計よりも長いことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項4】

前記第1の部材は前記基材と略平行となるように設けられることを特徴とする請求項1乃至請求項3に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項5】

前記第2の部材の長さと前記第3の部材の長さは異なることを特徴とする請求項1乃至

請求項4に記載の半導体装置の実装構造。

【請求項6】

基材上的一部に形成されている配線層と、前記配線層の一部である複数のパッド部を囲むように形成されているレジスト層と、を有する配線基板と、前記複数のパッド部の一方の上に電気的に接続するように半導体装置を設ける工程と、

前記複数のパッド部の他方の上と、前記半導体装置の上に接合材を設ける工程と、

前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と、に接するように接続部材を設ける工程と、

を有し、

前記接続部材は、前記複数のパッド部の他方の上に設けられている接合材と接する第1の接合部材と、前記半導体装置の上に設けられている接合材と接する第2の接合部材と、前記第1の接合部材と前記第2の接合部材と一定の間隔を設けて形成されている第1の部材と、前記第1の部材を支持し、前記第1の接合部材と接続している第2の部材と、前記第1の部材を支持し、前記第2の接合部材と接続している第3の部材を含むことを特徴とする半導体装置の実装方法。

【請求項7】

前記第1の部材は前記基材と略平行となるように設けることを特徴とする請求項6に記載の半導体装置の実装方法。